

SEMICON® JAPAN

セミコンジャパン2022 三菱電機出展のご案内

Automating
the World

日時

12/14^水 - 16^金 10:00 - 17:00

場所

東京ビッグサイト 東2ホール

小間番号

2505

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

【お問い合わせ先】

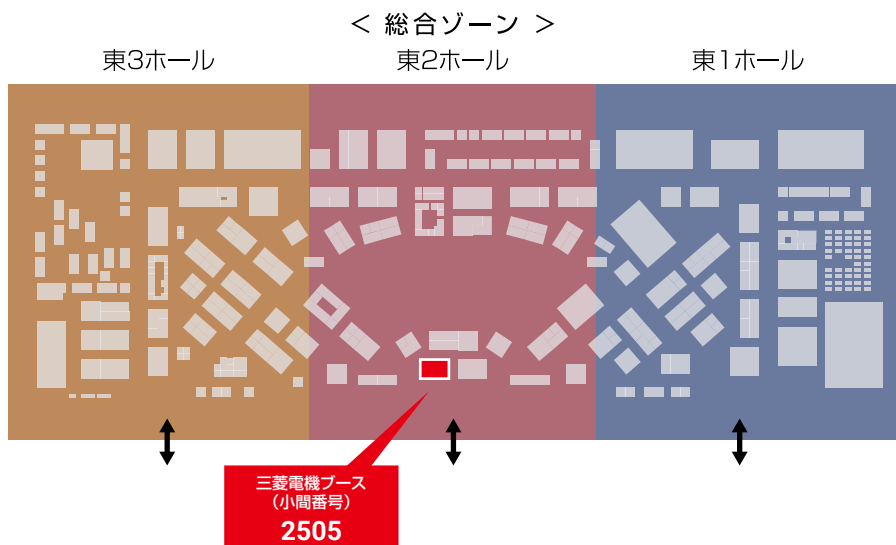
三菱電機株式会社産業メカトロニクス事業部

TEL.03-3218-6560 FAX.03-3218-6822

三菱電機FAサイト

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

ブースマップ



りんかい線	新木場駅	約5分	国際展示場駅(下車徒歩約7分)
	大崎駅	約13分	国際展示場駅(下車徒歩約7分)
ゆりかもめ	新橋駅	約22分	東京ビッグサイト駅(旧:国際展示場正門駅)(下車徒歩約3分)
	豊洲駅	約8分	東京ビッグサイト駅(旧:国際展示場正門駅)(下車徒歩約3分)

バス	<都営バス>		
	東京駅八重洲口	約40分	東京ビッグサイト (東16系統、豊洲駅前経由)
	東京駅丸の内南口	約40分	東京ビッグサイト (都05系統、勝どき駅前経由)
	門前仲町	約30分	東京ビッグサイト (門19系統、豊洲駅前経由)

空港バス(リムジンバス・京急バス)	羽田空港	約25分	東京ビッグサイト
-------------------	------	------	----------

水上バス	日の出桟橋(浜松町駅徒歩約7分)	約30分	東京ビッグサイト
------	------------------	------	----------

株式会社東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL:03(5530)1111(代表)

SEMICON Japan オフィシャルページ

www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register

※ご来場の際には、オフィシャルページにて事前に来場登録(無料)をしてください。



世界驚愕のスライス技術搭載マルチワイヤ放電加工機。

三菱電機 マルチワイヤ放電スライス加工機 「DS1000」

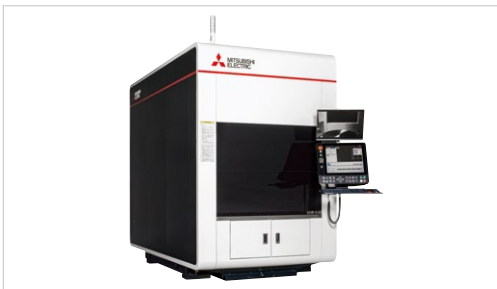
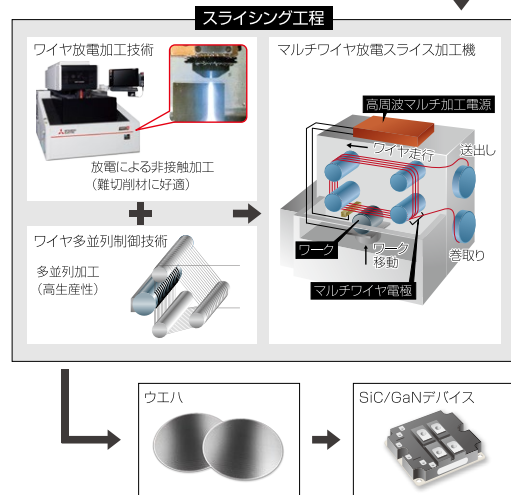
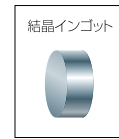
新技術「D-SLICE」を採用し、次世代半導体材料の放電スライス加工を世界で初めて*実用化。

※2019年9月12日現在。当社調べ



マルチワイヤ放電スライス技術： D-SLICE

放電加工の原理を活用した多並列ワイヤスライス技術により、ウエハスライス工程の生産性向上と製造コスト削減に貢献します



ワイヤ・レーザ金属3Dプリンタ「AZ600」

ワイヤ・レーザDED方式※1による高速・高品質造形を実現。レーザ照射部分に金属ワイヤを直接供給して造形する指向性エネルギー堆積方式(DDED方式)により、必要な箇所に必要な量の材料を造形することで、廃棄材料を抑えクリーンに三次元構造を造形。

※1 指向性堆積方式(Directed energy deposition方式)



電子ビーム金属3Dプリンタ「EZ300」

国内初の電子ビームを熱源とするPBF方式※2の金属3Dプリンタ。造形速度毎時250CCを実現し、製造現場の生産性向上とコスト削減に貢献。レーザが苦手な高反射材の造形もご提案。

※2 粉末床溶融結合方式(Powder Bed Fusion方式)



電子ビーム加工機

真空中で高密度に収束された電子ビームを対象物に照射することで、局所的かつ瞬時に加熱し、高精度な溶接や表面加工を実現。鉄系材料だけでなく、チタン、アルミニウム、銅などの高品位加工が可能ことから、自動車・航空・宇宙・原子力・建設機械から半導体製造装置などの先端分野にも広く使用。

※サンプルおよびサインネージでの展示です。実機の展示はありません。